

证券代码：688981

证券简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他 ()
参与单位名称	华泰证券、华兴资本、中信证券、海通证券、国信证券及通过电话和网络参加会议的各界人士。根据业绩说明会平台统计，共有超过九百位投资者等收听了此次业绩说明会直播。
时间	2023年11月10日
地点	网络/电话会议
公司接待人员姓名	联合首席执行官赵海军博士、资深副总裁兼董事会秘书郭光莉女士、资深副总裁兼财务负责人吴俊峰博士。
投资者关系活动主要内容介绍	
公司介绍	<p>中芯国际（证券代码：00981.HK/688981.SH）是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者，拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套，向全球客户提供 0.35 微米到 FinFET 不同技术节点的晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于中国上海，拥有全球化的制造和服务基地，在上海、北京、天津、深圳建有三座 8 英寸晶圆厂和四座 12 英寸晶圆厂；在上海、北京、天津各有一座 12 英寸晶圆厂在建中。中芯国际还在美国、欧洲、日本和中国台湾设立营销办事处、提供客户服务，同时在中国香港设立了代表处。</p> <p>详细资讯请参考中芯国际网站 www.smics.com。</p>
交流问答	<p>（在此提醒各位，我们今天的表述包括前瞻性陈述，是公司对未来业绩的预期而非保证，并受固有风险和不确定性的影响。请参阅我们业绩公告中的前瞻性陈述。除非另有说明，业绩说明会数据根据国际财务报告准则表述，所有货币数据均以美元表示。）</p> <p>● 资深副总裁、财务负责人吴俊峰博士发言：</p> <p>大家好。首先，我向大家汇报 2023 年第三季度未经审计的经营业绩，然后给出第四季度指引。</p> <p>第三季度的经营业绩如下：</p>

销售收入为 16 亿 2 千 1 百万美元，环比增加 3.9%。
毛利率为 19.8%，环比下降 0.5 个百分点。
经营利润为 8 千 7 百万美元，环比增加 9.5%。
息税折旧及摊销前利润为 9 亿零 1 百万美元，息税折旧及摊销前利润率为 55.6%。
归属于本公司的应占利润为 9 千 4 百万美元，归属于非控制性权益应占利润为 6 千 2 百万美元。

关于资产负债，在三季度末：

公司总资产为 468 亿美元，其中库存资金 174 亿美元。
总负债为 162 亿美元，其中，有息负债为 96 亿美元。
总权益为 306 亿美元。
有息债务权益比为 31.5%，净债务权益比为负的 25.2%。

关于现金流量，在三季度：

经营活动所得现金净额为收入 8 亿零 1 百万美元；
投资活动所用现金净额为支出 17 亿 1 千 1 百万美元；
融资活动所得现金净额为收入 3 亿 5 千 8 百万美元。

关于 2023 年四季度，我们的指引如下：

四季度销售收入预计环比增长 1%到 3%，毛利率预计在 16%到 18% 之间。

以上是财务方面的情况，谢谢。

● 联合首席执行官赵海军博士发言：

大家好，欢迎大家参加今天的业绩说明会。

市场方面，今年下半年没有出现大家年初时期望的 V 型或 U 型的反弹，整体仍停留在底部，呈现出了一个“Double-U”走势。在中国市场上，去年三季度开始出现的产品高水位库存问题已得到缓解，降到了一个比较健康的水平；终端和整机厂商对供应链进行了管理，对“在地化”进行了规划；中国客户的新产品需求较好，部分大宗产品供不应求，但同时也对老产品形成了降维打击，使尚存的老产品库存消化变慢，同质化低价竞争加剧。

全球不同区域去库存的速度和对新芯片的转换节奏不同。在手机、消费和工业领域，中国客户基本上到了进出平衡的库存水平，但美欧客户的库存依然处于历史高位；此外，紧张了三年的汽车产品的相关库存也开始偏高，已引起主要客户对市场修正的警觉并对下单迅速收紧！经过这一年多来的市场起伏，客户体验了从两年前的激进扩张到今年的辛苦防守，变得更加专注核心业务和研发投入，更加严格控制库存和成本，对流片下单也更加谨慎。

地缘政治因素给行业中长期的发展带来了重复建设和供应链的不确定性，带来了灰犀牛效应。产业链的各个环节都在探索战略和路径，我们也在持续谨慎观察和不断尝试。

公司方面，因为地缘政治和成本竞争带来的产业链重组，我们的客户在市场上的份额有所提升，带动了公司业务的增长。今年三季度公司销售收入为 16.2 亿美元，环比增长 3.9%，处于指引的中位；毛利率为 19.8%，较上季度下降 0.5 个百分点。公司整体出货量继续增加，环比增长 9.5%。由于不同产品需求的回温不均匀，大宗标准产品的占比较多，导致公司的平均晶圆单价下降，这个情况与上季度我们在业绩说明会上同大家的汇报是一致的。

销售收入以地区分类来看，海外的去库存节奏，特别是手机和消费类相关 IC，启动晚于国内，目前仍然处于去库存的困难时刻，使得中国区的占比进一步提升至 84%，其他地区收入占 16%。销售收入以服务类型分类来看，晶圆收入占约九成，其他收入占约一成，比例稳定。

晶圆收入以应用分类来看，智能手机、物联网、消费电子和其他类别收入占比分别为 26%，12%，24%和 38%。应用于国内终端的图像传感/图像信号处理、射频-蓝牙需求较好，环比增长 24%和 28%；显示驱动库存恢复至健康水位，销售收入环比继续增长 16%；特殊存储需求饱满，尤其是 NOR Flash，环比增长 27%。三季度 8 英寸收入略有回升，占比为 26%，增加一个百分点，但产能利用率仍低于 12 英寸；12 英寸收入占比为 74%。

今年的资本开支主要用于扩产和新厂基建，三季度公司资本开支为 21 亿美元，前三个季度总计约为 51 亿美元。鉴于地缘政治对设备交付周期的影响会越来越复杂，为保证已启动的项目达产，公司允许设备供应商提前交货，加之当前全球设备供应链的交付周期已经好转，所以公司在今年年底前进厂的设备数量将比原来的预测有大幅增加，全年资本开支预计上调到 75 亿美元左右。截至三季度末，公司折合 8 英寸月产能增至 79.6 万片，较年初增加了 8.2 万片。由于作为分母的总产能变大了，所以尽管三季度出货环比是增加的，但平均产能利用率还是下降了 1.2 个百分点，到 77.1%。

截止目前，除了晶背加工、双晶圆以及三晶圆铜-铜键合等市场以外，其他体量的市场没有新的动能和亮点。公司预计四季度将维持中规中矩态势，销售收入略有增长；毛利率将继续承受新产能折旧带来的压力，预计在 16-18%之间。近几年来，公司进行了持续的产能扩充和高资本支出，折旧数额持续增长，公司的毛利率也将承受愈来愈重的压力。

展望来年，我们看到市场已趋于稳定，对成熟代工的需求，会由于库存下降而增长，但没有大幅成长的动力和亮点，仍需等待全世界宏观经济

的复苏。我们认为这是来年的一个基本盘。在这样的大环境下，公司将继续做好自己的事，一步一个脚印，把握半导体长期需求增长的大趋势。

在此，我们再一次对长期关心、帮助和支持我们的各界人士表示感谢。谢谢大家。

● 问答环节：

问题 1：刚才您提了这次复苏不是 V 型也不是 U 型，而是 Double-U 型，具体能不能解释一下如何理解这个 Double-U（两个 U 型）？我们看到国内设计公司相关的收入环比在增长，毛利率也提升，我记得赵总去年提过一个讲法叫“速冻急停”，不知道现在这些国内客户的需求的复苏的可持续性和力度怎样？

回复：原来大家觉得可能这一次的下行是一年的时间，到了年底会恢复，（也就是一个 U 型）。现在看来，我们认为这个事情要放大一倍，是 Double U（两个 U 型）是两年。两个 U 中间会跳起来一点，也就是有个小行情。这一轮小行情是手机带动，集中在三季度内发布，有很多特定的人群几年没换手机了，所以这一轮大家都换手机。我们认为个小行情并不带动整个大的形势的变化，来年看起来手机整个的销售量基本跟今年是持平的。

问题 2：公司这次上调了资本开支到 75 亿美金左右。我看海关数据，九月份中国进口半导体设备达到了接近五十亿美金的金额，也就是国内很多厂商都在进口半导体设备。请问赵总，一是怎么看国内的成熟工艺的市场的供需关系？二是今年的资本开支这么高，怎么看明年的公司的扩产节奏？

回复：以前我也跟大家交流过，中芯国际一个工厂建立起来是准备运行二十年以上的，我们主要是看未来。建这些工厂有的赶上了行业的景气度顶峰时期，有的赶上了谷底，就像现在这样是下行周期。但不管怎么样，公司在未来二十年的运营中慢慢成长，这个对整体的发展并没有太大的影响。中芯国际有特定的情况，我们很多设备是要申请准证的，我们对设备到达的时间没办法准确地预测，最好的办法就是一起都申请了，一起下订单，供应商交货比较快，我们也允许它可以提前交货进厂。到了年底发现来的设备、可以交付的比原来预测的要多，这就是造成我们比原先预测的资本开支增加的原因。

从全球来看，整个需求没有产能扩建得快，所以应该是产能会过剩，需要时间慢慢地消化掉这几年急匆匆建起来的产能。但像一些特别大的市场地区，本地的产能还不能满足国内的整机整车系统厂商的要求。所以，我们是和客户做这样的联盟和绑定，中芯国际建设的产能，都是有跟客户事先做过沟通的。我们的信心还是比较高，认为在未来还是有客户的需求和订单的。

问题 3：公司过去发展特殊制程是蛮成功的，请问公司特殊制程的营收是多少？未来有什么新的布局？

回复：我们的特殊制程分为八大平台，包括超低功耗、射频、高压驱动、图像传感器等等。我们可以在成熟节点上做深耕细作，可以把每个产品跟客户一起做到第一梯队的水平，而且是多样化的。未来，我们第一是靠自己的技术和性能全面覆盖，能在第一梯队；第二是跟客户战略绑定，提供好的服务和质量；第三在国内和国际市场上我们有成本优势，可以参与最强的竞争。

问题 4：短期公司资本开支的折旧压力比较大，如果把时间拉长怎么看公司的长期毛利率？

回复：我们投入的资本开支大概七成是用于购买设备，剩下的部分用来买地、建厂房、做厂务等等。占到资本开支七成的设备折旧是五年到七年，你可以算出来折旧负担是多少。另一方面是我们的产能利用率，这个季度是 77.1%，通过我们的公告指引也会知道我们下个季度的营收会增长多少，大概能看出产能利用率。如果产能利用率是大致不变，那毛利率就可以推算出来下降一些。三季度毛利率是 19.8%，四季度我们预测是 16-18%。就是这样一个趋势。

问题 5：您提到需求可能恢复在延宕一年，我不知道您对这个供需平衡的预估，是基于对海外宏观的观测，还是说刚才您提到的地缘政治带来的一些重复建设的产能的冗余？如果恢复时间再等待一年的话，对于公司 24 年的整体的一个扩产的进度节奏的影响如何？

回复：我们第一是看中芯国际的客户以及市场的前二十大客户手里的库存；第二是看公司的流片新产品，它是要经历大约一年的周期才会到达终端手机厂商、汽车厂商、工业厂商的，所以来年年底的产品，应该已经在中芯国际的工厂里等待验证；第三按市场看，明年手机基本上与今年持平，或者上升 1~2%。所以基于这几项，我们做出的判断。

问题 6：如果明年再延宕一年复苏，现在看整个晶圆的价格与历史长期均值来看，应该还是相对比较高。不知道是不是未来几个季度的晶圆价格的下滑趋势还是要保持谨慎一些？

回复：三季度很多中小型的设计公司在手机和汽车领域都取得了历史上的最好业绩，中芯国际作为这些产品的一线供应商，价格是稳定的。但是对于大宗产品，中芯国际需要保证自己的产能利用率。大宗的产品就是随行就市，价格都是能查得到的，所以我们预见大宗产品晶圆价格在来年还会进一步的下降。

问题 7：公司 40/55 的产能需求是否依然紧张？产能的瓶颈机台是那些？

	<p>回复：40 纳米还是紧张的。CIS 大家都要做背部新产品，需要背部减薄工艺，对于背部晶圆处理有很高的要求，导致产能不足。这部分的供应商设备交货也比较慢。40 纳米的其他平台需求也比较好，例如 MCU、DDIC 等。55 纳米部分，CIS、DDIC、特殊存储等相关的需求也都很好。</p> <p>问题 8：三季度八英寸晶圆的收入有所提升，是否意味着模拟和电源管理类芯片格局有所好转？对未来八寸怎么判断？</p> <p>回复：这次小阳春，手机相关的快充、电源管理、蓝牙、wifi 等都是八英寸的，需求量恢复了一些。如果明年跟今年整体平均是差不多，那么现在的产能利用率会维持相当长一段时间。全世界的八英寸产能利用率在 50%-70%附近，整体不会有特别大的改观。</p> <p>如需了解完整版业绩说明会，请在此报告发布一年内访问中芯国际官网收听完整版语音记录。</p>
<p>是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>沟通内容基于公司已公开披露信息。</p>